

LCP 日本新石油化学MG-350-B连接器专用LCP塑胶原料更多信息

产品名称	LCP 日本新石油化学MG-350-B连接器专用LCP塑胶原料更多信息
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

一般塑胶原料的刚度比金属低一数量级;

塑胶原料的疲劳数据还很少,需根据使用要求加以考虑。

POM塑胶原料系列可注塑成型，挤出成型，压缩成型，滚塑成型，吹塑成型。应用于齿轮，链轮，滑轮，滑轨，弹簧，支架，卫浴，阀门，导轨，剃须刀，水，夹子，电动牙刷，插座，开关零件，燃油系统部件，玩具，洗衣机，轴承，工具把手，密封垫，淋浴喷头，外壳，座椅安全带扣，拉链，卡扣，纽扣，板材，杆，板料，结构部件和机加工。

EEK目前已广泛成熟应用于航天航空、军工、医疗、电子半导体、汽车、石油石化、分析仪器、饮料灌装、电子烟等使用工况和要求苛刻的高端领域，市场需求潜力巨大。

汽车制造：聚醚醚酮PEEK一直成功地用于汽车制造业，由于它具有良好耐摩擦性能，可以替代金属（包括不锈钢、钛）制造发动机内罩、汽车轴承、密封件和刹车片等。

6T塑胶材料连接器厂家表示，这种材料一般是用在2.54间距贴片排母，和1.27间距/2.0间距系列排母上。耐焊接温度在260度-290度之间，所以使用这种材料生产的排母连接器成本略高，选择这种材料一般是客户在产品上有质量的要求。

POM的加工温度范围很窄（195-215 ），在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 就会分解（均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 ）。螺杆转速不能过高，残量要少。

LCP塑胶原料可以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。

用液晶作成的纤维可以做鱼网、防弹服、体育用品、刹车片、光导纤维几显示材料等，还可制成薄膜

，用于软质印刷线路、食品包装等。

Admer，是由改性聚乙烯、改性聚丙烯组成的一种改性聚烯烃，由于在聚烯烃链上引入了粘合性官能团，使之在与EVOH等空气阻断树脂、金属、玻璃纤维、陶瓷等粘合时拥有特强的粘合性。通过共挤出成型，可以制作多层的片材、薄膜、管材、瓶材等多种制品。

LCP塑胶原料已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件；用于电子电气和汽车机械零件或部件；还可以用于医疗方面。

电气绝缘性能好 大多数塑料具有优良的电绝缘性，这是因为高分子内部没有自由移动的电子和离子。所以不具备导电能力，但是由于添加剂的加入。使得塑胶原料的电绝缘性能产生了一些变化；大多数塑胶原料在低频、低压时绝缘性很好，少数塑胶原料即使在高频、高压下也有良好的绝缘性，因此，塑胶原料被广泛用于电子、电气、通讯、仪器等领域中。

POM的熔体粘度对剪切速率敏感。因此，要提高熔体流动性，不能单用提高温度，也要从提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品，注射压力为40~80MPa；一般制品为100MPa左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品，注射压力较高，为120~140MPa。

POM产品收缩大（为了减小成型后收缩率可选用高一些的模式），易产生缩水或变形。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。